



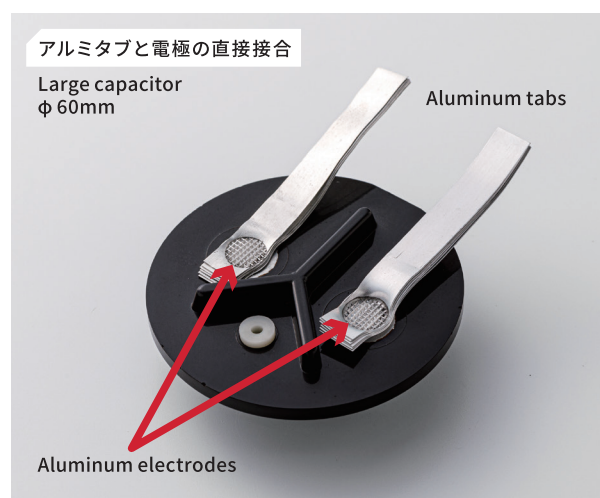
Patented

Application

Bonding ボンディング

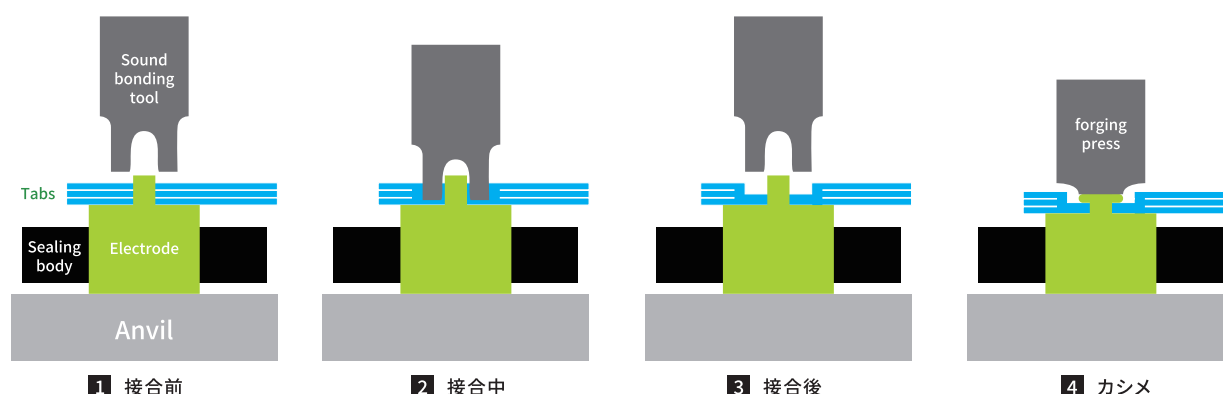
大型コンデンサ 積層タブの音波接合

アルミ電極への多層タブ 接合



アルテクス推奨

タブと電極の直接接合+カシメで
特性アップと確実な固定



Product used 使用する装置

20MZs



AP-J-0050A4-2019111201